

## KLA 推出全面的 IC 载板产品组合，开启先进半导体封装新时代

- 新产品组合通过基板的互连创新提升芯片性能
- KLA 延续了经过市场验证的 Corus™ 直接成像的技术，推出 Serena™ 直接成像平台，以支持主流及先进 IC 载板的光刻需求
- 新的 Lumina™ 检测和量测系统进一步协助 IC 载板（包括玻璃基板）和面板中介层制造商高效地生产高品质和高良率的先进产品

加利福尼亚州米尔皮塔斯，2024 年 10 月 15 日 – 今天，KLA 公司 (NASDAQ: KLAC) 推出了全面的制程控制和制程支持解决方案，适用于 IC 载板 (ICS) 制造。KLA 在半导体制造前道工艺、封装和 IC 载板方面的综合专业知识，将有助于客户在针对高性能应用的芯片封装互连密度方面取得突破。



KLA 公司现在为 IC 载板制造提供业内最全面的制程控制和制程支持解决方案。随着基于面板的中间封装级别（如 IC 基板和中介层）的创新加速，客户需要新的解决方案，以在针对高性能应用的芯片封装互连密度方面取得突破。

先进封装继续采用异构集成技术，将多个半导体元件整合在一起，以提升性能、功耗和成本效益。为了满足日益变化的互连需求，IC 载板和中介层面板封装水平的创新变得越来越快。这些



技术用于有效地连接芯片和印刷电路板 (PCB)。随着封装尺寸的增加、特征尺寸的减少以及新型材料（如玻璃）的推出，制造商可以充分利用 KLA 的解决方案组合来实现更高的良率，加快交付周期，并提升整体盈利能力。

KLA 的全面产品组合包括直接成像 (DI)、缺陷检测、成形、量测、化学工艺控制和智能软件解决方案，优化了先进的封装制造工作流程。

KLA 的产品组合包括多种直接成像解决方案，支持各式客户的光刻需求。Corus™ 直接成像平台被市场认可，验证了其可提供高灵活度与高效成像解决方案的可靠能力。为满足 IC 载板和下一代高密度互连 (HDI) 等不断变化的应用需求，新一代光学和激光技术也在一直不断地升级功能，即使针对不同形态的面板，也能快速优化动态成像与实现高层间精度。

针对先进 IC 载板的应用，直接成像在 stepper 光刻机领域打开了全新类别。KLA 正在推出新的 Serena™ 直接成像平台，是一款灵活多用的数字解决方案，用于大尺寸、多层数有机载板进行高品质和更细致的线路成像，从而提高精度和良率。

Lumina™ 是 KLA 针对先进 IC 载板（包括玻璃基板）和基于面板的中介层的新型检测和量测系统，能以更佳的拥有成本实现高灵敏度检测和扫描量测。该系统提供搭配人工智能审核与分类的监测功能，可生成无需操作员介入的可操作缺陷帕累托图，并与 KLA 的成形解决方案无缝接轨。

经验证的 KLA 制程控制解决方案产品线使得产品组合进一步强化，其中包括 Orbotech Ultra PerFix™、EcoNet™、Zeta™-6xx、ICOS™ T890、Quali-Fill® Libra® 和 QualiLab® Elite。KLA 的 Frontline 软件解决方案涵盖工程、计算机辅助制造 (CAM) 和生产数据资料分析，在 IC 载板制造过程中集中和应用人工智能，以长期确保 KLA 在良率管理方面的领先地位。

KLA 公司执行副总裁暨首席策略官 Oreste Donzella 表示：“通过今天发布的产品组合，KLA 奠定了在半导体生态系统创新方面的领导地位。IC 载板和其他面板级封装技术对于推进未来高效能芯片的连接至关重要，KLA 正与客户协作，解决复杂的生产挑战，以最大限度地提高良率并助力成功。



若想了解关于 KLA 全面 IC 载板解决方案组合的更多信息，诚意邀请您参与即将举行的 [TPCA 展会](#)。

## 关于 KLA

KLA Corporation ( " KLA " ) 开发行业领先的设备并提供服务，推动整个电子行业的创新。我们为晶圆和光罩、集成电路、封装和印刷电路板的制造提供先进的制程控制和制程支持解决方案。通过与全球领先客户的紧密合作，我们的物理学家、工程师、数据科学家和问题解决专家组成了设计解决方案的专家团队，推动世界前进。投资者和其他相关人士请注意，KLA 使用投资者关系网站 ([ir.kla.com](http://ir.kla.com)) 发布重大财务信息，包括美国证券交易委员会的档案、新闻稿、公开财报电话会议和会议网络直播。更多信息，请访问：[www.kla.com](http://www.kla.com)。

## 前瞻报表

本新闻稿中的声明（除历史事实之外），例如关于 IC 载板产品组合预期表现的声明，乃前瞻的声明，并受 1995 年《证券诉讼改革法》制定的免责规定的约束。以上前瞻声明乃基于当前的信息和预期，涉及风险和不确定因素。由于各种因素，包括新技术的延后运用（无论是基于成本、绩效问题或其他原因），实际结果可能与此类声明中的预测结果存在重大差异。其他公司引入竞争产品，或影响 KLA 产品实施、绩效或使用的不可预见技术挑战或限制，以及截至 KLA 2024 年 6 月 30 年度的 10-K 表的年度报告中所包含的其他风险因素，以及 KLA 向证券交易委员会提交的其他文件（包括但不限于其中所述风险因素）。KLA 不承担更新这些前瞻声明的义务，目前也无意图进行更新。

投资者关系：Kevin Kessel，投资者关系副总裁，[kevin.kessel@kla.com](mailto:kevin.kessel@kla.com)

媒体关系：Mike Dulin，企业传播，[michael.dulin@kla.com](mailto:michael.dulin@kla.com)

+++++